



推奨基板取付け寸法 (非累積公差)
 RECOMMEND PC BOARD HOLE (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
 PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
 基板厚: 1.6±0.1

NUMBER 316517
 METRIC
 三線法(3rd ANGLE PROJECTION)

PROJ NO. 395-623
 単位: 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST
 AMP-J
 REV.10/83

NOTES

1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, UL94V-0
 CONTACT: COPPER ALLOY
 RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- △2. FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
- △3. FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
- △4. FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- △5. FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- △6. FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性樹脂, UL94V-0
 コンタクト: 銅合金
 リテンションレグ: 銅合金
- △2. めっき: コンタクト接触部: ニッケル下地の上に金めっき 0.38 μm MIN
- △3. めっき: コンタクト接触部: ニッケル下地の上に金めっき 0.76 μm MIN
- △4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地 接触部: 2.0 μm MIN スズめっき
- △5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部: ニッケル下地の上に半田めっき
- △6. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部: ニッケル下地の上にスズめっき

△6	△4	-5
△6	△3	-3
△6	△2	316517-2
FINISH	型番	PART NUMBER

Copyright ©1995 年		Copyright ©1995 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
B REVISED (FJD0-0039-03) T.S. J.M. 10/25		A REVISED (FJD0-0114-03) T.S. S.M. 10/25		O RELEASED FJ00-3261-95 N.M. Y.I. 10/24	
LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR	CHK	DATE	CHK.
Y. ISHIKAWA		S. MANABE		Y. ISHIKAWA	
DR. 24 OCT 95 N.MATSUBARA		DE. 24 OCT 95 N.MATSUBARA		APP. 24 OCT 95 S.MANABE	
材料 (MATERIAL) (SEE NOTE)		仕上 (FINISH) (SEE NOTE)		名称 (NAME)	
注記参照		注記参照		DYNAMIC (D-3500) 20 POS. V HDR. ASS'Y	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		A3		LOC J	
10mm以下: ±0.35		10mm以上 30mm以下: ±0.4		30mm以上 100mm以下: ±0.45	
角 度: ±3'		尺 寸 (SCALE) 2/1		REV. B	
				SHEET 1 OF 1	

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)